

BRAZING FILLER METAL FOR LEAD PIN

Patent Number: JP6126485
Publication date: 1994-05-10
Inventor(s): IWAI SHOZABURO
Applicant(s): TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK
Requested Patent: JP6126485
Application Number: JP19920306046 19921019
Priority Number(s):
IPC Classification: B23K35/30; B23K35/26; H01L23/50
EC Classification:
Equivalents: JP3086086B2

Abstract

PURPOSE: To assure the uniform height of lead pins without the irregularity thereof by preparing the brazing filler metal for lead pins contg. Au in a specific range and consisting of the balance Sn.

CONSTITUTION: This brazing filler metal 5 for lead pins consists of 78 to 79.5% Au and the balance Sn. The brazing filler metal 5 for lead pins having such component compsn. is mostly the eutectic structure of the Au and the Sn and slightly Sn-rich crystals appear therein but the Sn rich crystals are fine and, therefore, the irregularity in the height at the time of brazing the lead pins 1 does not arise. Substrates or the lead pins, etc., are often subjected to Au plating in order to improve brazer flow or to improve reliability. The Au of the Au plating component is taken in to form the AuSn eutectic structure at the time of soldering even if the brazing filler metal 5 for lead pins has the Sn-rich crystals and, therefore, there are no troubles at all.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-126485

(43)公開日 平成6年(1994)5月10日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
B 23 K 35/30	310 A	7362-4E		
35/26	310 A	7362-4E		
H 01 L 23/50	L	9272-4M		
	P	9272-4M		

審査請求 未請求 請求項の数1(全3頁)

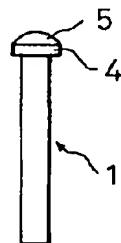
(21)出願番号 特願平4-306046	(71)出願人 000217228 田中貴金属工業株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号
(22)出願日 平成4年(1992)10月19日	(72)発明者 岩井 正三郎 神奈川県平塚市新町1番75号 田中貴金属 工業株式会社平塚工場内

(54)【発明の名称】 リードピン用ろう材

(57)【要約】

【目的】 ろう付け時Auリッチ晶が殆んど表れず、Au-Sn共晶となり、僅かにSnリッチ晶が表れても微細である為、リードピンが不揃いとなることがなく、均一な高さとなるリードピン用ろう材を提供する。

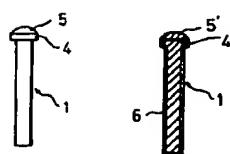
【構成】 Au 78~79.5%、残部Snよりなるリードピン用ろう材。



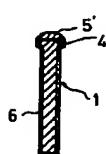
(3)

特開平 6 - 1 2 6 4 8 5

【図1】



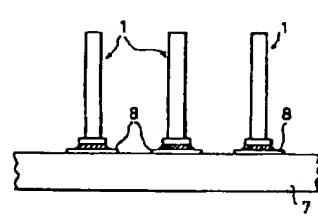
【図2】



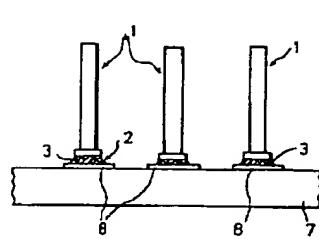
【図3】



【図4】



【図5】



BEST AVAILABLE COPY